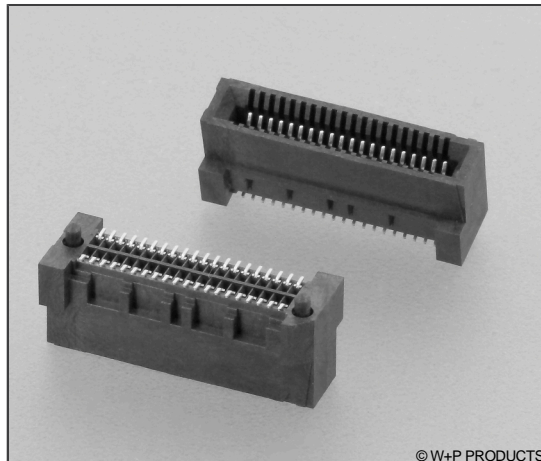


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3,1 A bei 30°C Erwärmung <i>3.1 A at 30°C Temperature Rise</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Steckkarten mit einer Stärke von 1,57±0,157mm

For 1.57±0.157mm card edge thickness

Übertragungsverlust -3dB

Insertion loss -3dB

Stapelhöhe 7,98mm

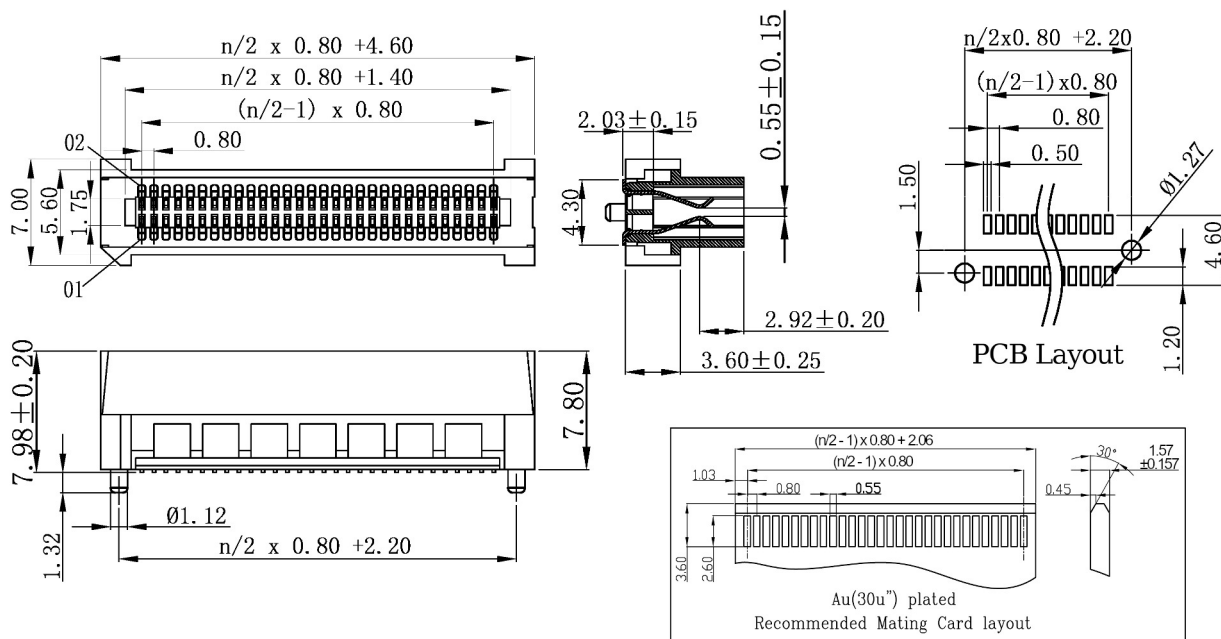
Stack height 7.98mm

Asymmetrische Übertragung 8GHz/16Gbps

Single-ended Signaling 8GHz/16Gbps

Symmetrische Übertragung 10.5GHz/21Gbps

Diff. pair signaling 10.5GHz/21Gbps



Series	Contacts*	Type	Plating*	Packaging*
1280	40 20/40/60	1 1 Standard	80 00 Au flash 60 Sel. Au flash /Sn 80 Sel. 0,75µm Au /Sn	PPST ST PPST PPTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*

PPST In Stangen mit PP-Pads / *In tubes with PP-Pads*

PPTR Tape & Reel mit PP-Pads / *Tape & Reel with PP-Pads*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

